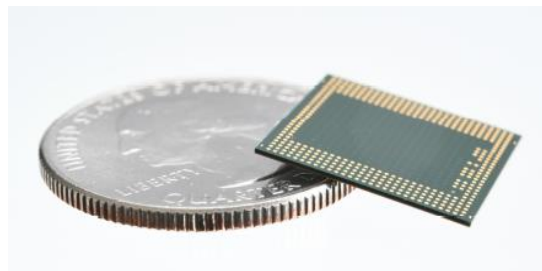


MCEP[®] ～デバイス内蔵パッケージ～

*MCEP (Molded Core embedded Package : エムセップ)。MCEPは新光電気工業㈱の登録商標です。また、本製品に関する特許も取得しております。

概要

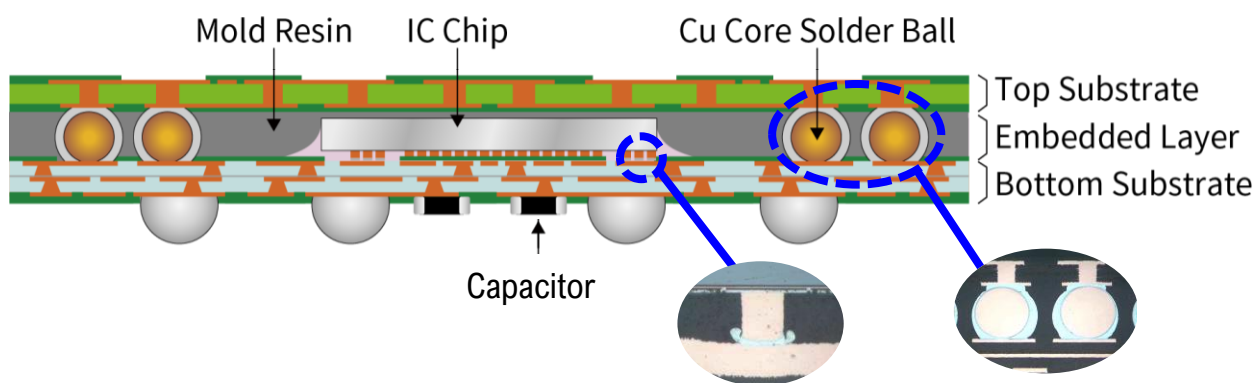
MCEP[®]は、ICチップや能動・受動部品を内蔵した半導体パッケージです。新光電気独自の半導体パッケージング技術を駆使し、優れた電気特性と高い信頼性を備えた小型・低背パッケージとして、小型電子機器や各種モジュールにご採用いただいております



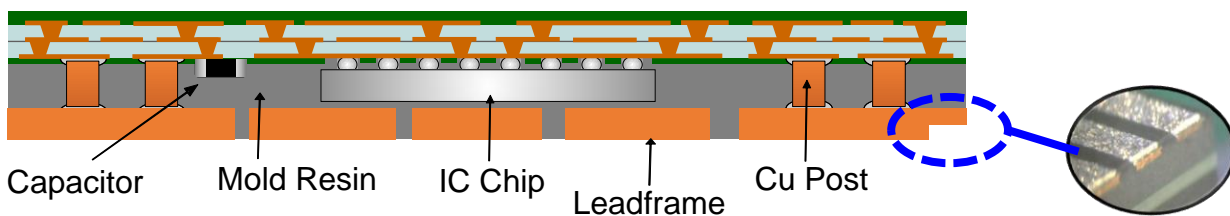
特徴

- 組立プロセスのみでICチップや能動・受動部品内蔵を実現
- 小型化・低背かつ低反り化に優れた半導体パッケージ構造
- パッケージ表面のデザインフレキシビリティ
- 高歩留り・高信頼性を裏付ける豊富な量産実績

構造



- 応用例：高放熱モジュール（開発中）



用途

- モバイル用、AR/VR用、ドローン用アプリケーションプロセッサ
- 画像処理プロセッサ
- アンテナパッケージ
- センサーパッケージ
- SSDメモリー用コントローラー
- 車載用ドライバステータスマニター

